

Техническая информация

Флюс-гель ФРК 525-3К-10

В соответствии с ТУ 1718-001-32478424-13

Флюс-гель с повышенной клейкостью **ФРК 525-3К-10** на основе канифоли, средней активности некоррозионный слабоактивированный, **ROM0**.

Разработан для пайки электронных компонентов и полупроводников и других компонентов в выводном и безвыводном исполнениях. Применяется для пайки труднодоступных поверхностей благодаря хорошей растекаемости. В состав флюса входят компоненты, которые делают его универсальным по возможности удаления остатков.

Флюс не содержит легколетучих соединений.

Совместим со всеми видами припоев.

Остатки после пайки легко смываются водой.

Технологический процесс (температурный режим пайки до 270°)

- поверхностный монтаж
- ручная пайка
- пайка оплавлением
- групповая пайка
- лужение выводов и проводов
- ремонтные работы
- другие случаи использования флюса

Паяемый материал

- медь, медные сплавы, в т.ч. латунь
- оловянно-свинцовые поверхности
- бессвинцовые поверхности
- иммерсионные поверхности
- никель
- керамические и металлизированные поверхности, кристаллы
- OSP-поверхности

По показателям поверхностного сопротивления изоляции (SIR) и электрохимической миграции (ECM) флюс отвечает требованиям по использованию в электронике при монтаже компонентов и модулей.

Спецификация Флюса ФРК 525-3К-10

Параметры	Результаты испытаний	В соответствии с НД
Тип флюса	Канифольный, ROM0	J-STD-004B МЭК 61190-1 ISO 9455
Цвет	Красно-коричневый	J-STD-004B МЭК 61190-1
Вязкость	100 Па·сек	МЭК 61190-1 Раздел . п. 4.2.6.3
Клейкость	97 г	J-STD-005B

Плотность	1.368 г/см ³	МЭК 61190–1 метод 4.2.6.2
Запах	Слабый амминный	
Содержание галогенидов	Отсутствуют	J–STD–004B, п. 3.4.1.3
Испытание на реакцию Медного зеркала (пробой менее 50%)	Испытание прошел, минимальные точечные пробои в стекле, средней активности, М-типа	J–STD–004B, п.3.3.4.1.1 ISO 9455–5
Индукционная коррозия после пайки на медном купоне	Испытание прошел, позеленение медного купона не наблюдается, некоррозионный слабоактивированный	J–STD–004B, п.3.4.1.2 ISO 9455–15
Кислотное число	(39±2) мг КОН/г	J–STD–004B, п.3.6.1 и ISO 9455–3
Поверхностное сопротивление изоляции (SIR)	Прошел тест как годный	Telcordia Belcore G–R 78 CORE, раздел 13.1 ISO 9455–17
Электрохимическая миграция (ECM)	Прошел тест как годный	J–STD–004B, п.3.4.1.5
Смачиваемость	Прошел тест на баланс смачивания	J–STD–004B, Примечание В ОСТ 4Г.0.033.200
Тип отмывки	При необходимости рекомендовано отмывать средствами на основе органических растворителей типа ОФ-1	J–STD–004B
Совместимость с припоями	Согласовывается с потребителем	

Температура нанесения

- (18 ÷ 25)°C

Температура начала активации

- (100 ÷ 125)°C

Температура пайки

- свинцовая пайка (220 ÷ 225)°C
- бессвинцовая пайка до 270°C

Максимальная температура жала паяльника 340°C.

Время пайки не регламентируется в виду стабильности флюс-геля в режиме повышенной температуры.

Дополнительная информация по использованию

При нанесении флюса и монтаже FLIP-CHIP-компонентов необходим строгий контроль влажности – RH (35 ÷ 50)%.

Необходимо контролировать толщину пленки флюса; она не должна превышать 50 мкм. Минимальная толщина пленки зависит от различия высот выводов на каждом компоненте. Покрывать флюсом необходимо только нижние поверхности выводов. Приблизительный расход флюса составляет 4 мкг на 1 мм² платы.

Время флюсования компонента составляет (5 ÷ 15) сек.

Время оплавления в печи - до 300 сек.

Меры безопасности

При использовании флюса следует придерживаться мер безопасности, предусмотренных при работе с подобными веществами; хранить флюс необходимо в сухом, хорошо вентилируемом помещении, подальше от открытого пламени.

Вдыхание паров флюса, которые выделяются при повышенных температурах при проведении пайки, могут вызвать головную боль, головокружение и тошноту. Избегать попадания флюса в глаза и на кожу. После работы с флюсом обязательно вымыть руки.

Фасовка

- шприц: 10 мл, 30 мл

Хранение

- срок хранения 3 года
- наиболее оптимальные условия хранения - при температуре ниже 20°C и влажности менее 70%.